

求人情報

企業コード:88428 ジョブコード:20230711-112-01-090

マネージャーレベル

ポジション名	【工程管理(ワイヤーボンディング工程)熊本】不良率削減・生産性改善
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート (リクルートエージェント / Recruit Agent)
企業名	(株)アムコー・テクノロジー・ジャパン
掲載開始・更新	2024-05-10 / 2024-05-14
職種	電機 (電気/電子/半導体) - プログラマー(制御系)
業種	半導体・電気・電子部品メーカー
勤務地	アジア 日本 熊本県
仕事内容	<p>世界シェア2位、日本ではシェア1位の半導体後工程受託メーカーにて、ワイヤーボンディング工程における生産性改善・向上、不良率削減、コスト低減などの取り組みをお任せします。</p> <p>■ワイヤボンド工程担当(条件出し、生産性改善、不具合改善、データ纏め) ■アセンブリ全般 生産性改善、生産性向上、不良率削減、コスト低減</p> <p>【働き方】フレックス制度：業務を調整しつつ活用することが可能です。</p>
企業について(社風など)	<p>■半導体後工程受託(ウェハテスト、アセンブリ、ファイナルテスト、ベアチップ、外観検査、パッケージ・テスト開発)</p> <p>従業員数 3500名</p>
応募条件	<p>【必須】 ■半導体に関する業務経験 ■生産性改善、不良率削減、コスト低減等に従事した経験</p> <p>【会社について】 ■導体製造の「後工程」に特化し、業界を牽引しているリーディングカンパニー。業界シェアは世界第2位、国内ではトップに位置し、革新的な事業展開で半導体の発展に寄与。</p> <p>■半導体パッケージ・テスト企業 国内売上No.1、アムコーグループでは世界で売上No.2。世界でトップクラスの品質と技術力を持った半導体のパッケージ・テスト企業。</p>
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢 (日本語能力試験1級又はN1)
年収	日本・円 350万円 ~ 650万円
休日	年間休日 120日
契約期間	正社員